

表 5大信頼産業の主要目標と政策

産業	目標	主な政策
半導体	・ファウンドリーとパッケージ産業において世界をリードする地位を維持する。 ・IC設計産業は世界2位以内を維持し、2028年に先進プロセスの採用比率を50%を達成する。 ・半導体材料産業の生産額を3割増加させ、528億元に引き上げる。 ・半導体設備産業の生産額を倍増させ、800億元に引き上げる。 ・半導体産業全体の新規生産増加額を2兆6,000億元に増加させ、給与水準の高い就業機会を25万増やす。	・2.5D/3D等のヘテロジニアス・インテグレーション(注)の先進パッケージ技術を発展させる。 ・シリコンフォトニクスなど先進プロセス技術の開発を進める。 ・台湾産設備を採用することを奨励及び材料の自主生産を進める。 ・IC設計の研究開発補助を推進。 ・先端IC設計人材を育成。 ・IC設計のスケール化と効率化を促進。 ・化合物半導体、量子チップ、その他の先進チップの開発を推進する。
AI	・AI、ソフトウェア、情報セキュリティなどのデジタル産業の生産額について、2026年に1兆元を突破する。 ・4年以内にAIなどのデジタル人材を20万人育成する。 ・デジタル産業におけるAIの応用普及率を50%に引き上げる。 ・製造業におけるAIの応用普及率を30%に引き上げる。	・補助や調達、税優遇などにより各種産業におけるAI導入を促進する。 ・産学連携による修士以上の高度人材を育成する。 ・国家発展基金による関連企業への投資、デジタル発展部による100億元の投資プロジェクトを企画。 ・半導体及びAIの世界大手による台湾へのR&Dセンター設立を促進する。
軍事産業	・ドローンの非レッドサプライチェーンを打ち立て、アジアにおけるドローンの民主サプライチェーンの中心となる。 ・ドローン産業の生産額を2028年に300億元に引き上げる。 ・ドローンの月間生産能力を1万5,000機に引き上げる。 ・恒温鍛造生産ラインを建設し、航空・宇宙産業のコア材料生産の能力を掌握する。 ・海上巡視艇の累計製造数を2018年までに165隻とする。	・ドローンおよび制御システムのコア技術確立する。 ・非レッドサプライチェーンの需要に応え、国際協力を推進し、技術を導入する。 ・嘉義にスタートアップのハブおよび生産クラスターを作り、生産能力を強化する ・航空機産業を発展させ、エンジン鍛造などのコア技術および製品を発展させる。 ・無人船や無人水中航走体(UUV)等の技術確立する。
セキュリティ産業	・情報セキュリティ産業の生産額を1,000億元以上、セキュリティ産業の生産額を300億元以上に引き上げる。 ・アジア最大規模の情報セキュリティ展示会を開催する。 ・高付加価値なハードウェアセキュリティを開発する。	・AIoTを活用したスマートセキュリティのニーズに合わせ、ハードとソフトを融合させた高付加価値なプロジェクトを発展させる。 ・情報セキュリティ企業が量子暗号技術等の先端技術を開発することをサポートする。 ・半導体設備の国際情報セキュリティ標準を推進する。
次世代通信	・6G基地局のソフトウェア、ハードウェアの自主生産率を80%へ。 ・低軌道衛星の通信システムおよびコア部品の自主生産率80%へ。 ・2027年に初のBeyond5G低軌道通信衛星(B5G)を打ち上げる。 ・衛星通信ネットワークおよび応用サービスの開発における生産額を300億元に引き上げる。	・6Gの自主技術を開発するとともに、世界の主要サプライヤーとパートナーを連携する。 ・低軌道衛星本体および搭載通信機器、地上設備を発展させる。

(注) CPU、メモリー、センサーといった異種デバイスを一体化してパッケージングする。

(出所) 行政院